



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1039—2015

挠性印制线路板用压延铜箔

Rolled copper foil for flexible printed circuit board

2015-04-30 发布

2015-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准负责起草单位:菏泽广源集团山东天和压延铜箔有限公司、有色金属技术经济研究院、中铝上海铜业有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司。

本标准主要起草人:于连生、徐继玲、常保平、张芬、薛方忠、陈伟文、邵胜忠、张孟良、胡文江、汪东兴、许丙军、苟薇娟。

挠性印制线路板用压延铜箔

1 范围

本标准规定了挠性印制线路板用压延铜箔的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单(或合同)内容等。

本标准适用于制造挠性印制线路板用压延铜箔(以下简称铜箔)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2036—1994 印制电路术语

GB/T 5121(所有部分) 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231 加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 10610 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法

GB/T 26303.3 铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法 第3部分:板带材

GB/T 29847—2013 印制板用铜箔试验方法

3 术语、定义和符号

GB/T 2036—1994 界定的以及下列术语、定义和符号适用于本文件。为便于使用,以下重复列出了GB/T 2036—1994中的某些术语和定义。

3.1

可低温退火压延铜箔 **copper foil as rolled-wrought-low temperature annealable**

可在使用过程中经低温热处理后性能达到一定要求的压延铜箔。

3.2

粘结增强处理 **bond enhancing treatment**

改善金属箔表面与相邻材料层之间结合力的处理。

[GB/T 2036—1994,定义 3.2.53]

3.3

蚀刻 **etching**

用化学或电化学方法去除基材上无用导电材料形成印制图形的工艺。

[GB/T 2036—1994,定义 5.3.19]

3.4

可焊性 **solderability**

金属表面被熔融焊料润湿的能力。

[GB/T 2036—1994,定义 6.4.12]